

SP7-2A08BG



2.3TB HBM3e, 생성형 AI를 위한 연산 밀도

최신 NVIDIA Blackwell Ultra 8-GPU 플랫폼을 탑재해 고도화된 AI 모델을 위한 극한의 연산 밀도와 대역폭을 제공하는 10U AI 트레이닝 서버입니다. 진보된 전원·냉각설계로 안정성을 확보했으며, 듀얼 프로세서 시스템으로 최신 Intel 프로세서를 지원해 다양한 AI 도입 환경에 유연하게 대응합니다.



서버 기술적 특징

NVIDIA Blackwell Ultra 8-GPU

NVLink·NVSwitch 인터커넥트로 연결된 HGX™ B300 8-GPU(GPU당 270GB, TDP 최대 1100W)를 지원해 최고 수준의 AI 연산 성능을 제공.

생성형 AI를 위한 메모리 대역폭

2.3TB HBM3e 메모리와 64TB/s의 GPU 메모리 대역폭으로 생성형 AI 워크로드의 대규모 파라미터 처리와 학습 효율을 극대화.

대용량 시스템 메모리

DDR5 6400MT/s DIMM을 32개(최대 8TB) 또는 24개(최대 6TB)까지 지원하며, Intel® Xeon® 6 프로세서 2개로 GPU 성능을 뒷받침.

안정적인 전원·발열 설계

12V/54V 분리 급전과 PDU 레벨 N+N 리던던시, PSU 이중화(N+1 또는 N+N)로 무중단 운영을 지원. 전면 I/O 설계로 장애 지점을 줄이고 신호 안정성을 향상.

고효율 공랭 설계

80×86mm 핫스왑 팬 20개를 적용한 고효율 냉각 설계로 고밀도 GPU 구성에서도 안정적인 열 관리를 구현.

강력한 네트워크·스토리지 확장

CX8 인피니밴드 포트 8개와 풀하이트 N-S 네트워크 패브릭 4개를 지원하며, U.2 NVMe 최대 8개와 M.2 NVMe 2개, RAID 카드 확장까지 대응.

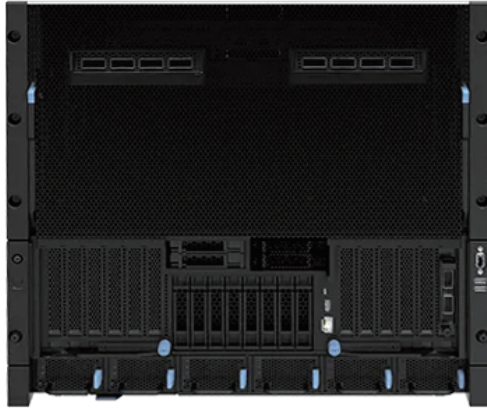
제품 사양

CPU	• Intel® Xeon® 6700 / 6900P 시리즈 프로세서 2개 • 최대 TDP 500W	Network	• OCP 3.0 1개 (옵션, Intel Xeon 6700 SKU 전용)
GPU	• NVIDIA Blackwell Ultra 8-GPU (HGX™ B300, 270GB) • GPU당 TDP 최대 1100W • NVLink·NVSwitch 인터커넥트	I/O	• USB 3.0 3개, VGA 1개, RJ45 1개 • MicroUSB 1개, Type-C 1개
Memory	• DDR5 6400MT/s DIMM 24개, 최대 6TB DDR5 ECC • 또는 DDR5 6400MT/s DIMM 32개, 최대 8TB DDR5 ECC	Cooling	• 공랭 방식 • 80×86mm 핫스왑 팬 20개
Storage	• 8× NVMe U.2 + 2× SATA/NVMe M.2 • 4× SAS/SATA 2.5인치 드라이브 (RAID, 옵션)	Power	• 6× 3300W 54V 듀얼 AC, N+1 또는 N+N 리던던트 • 2× 3200W 12V, N+1 리던던트
Expansion	• CX8 포트 8개 + PCIe 5.0 x16 FHFL 4개 • CX8 포트 8개 + PCIe 5.0 x16 FHFL 2개 /PCIe 5.0 x8 FHFL 4개 (Xeon 6700 SKU)	Management	• ASPEED AST2600 BMC, 듀얼 ROM(BMC+BIOS) 리던던시 • TPM 2.0 (Trusted Platform Module)
		Chassis	10U 랙 서버 • 폭 447mm × 높이 440mm × 깊이 890mm

SP7-2A08BG



제품 구성안



8x U.2 NVMe + Front I/O

기본구성으로 이루어진 플래그십 스탠다드 솔루션



Basic Configuration

후면 프레임으로 구성된 기본적인 솔루션

주요 기업 및 공공기관

다양한 공공기관 및 기업에서 검증된 성능 및 안전성

